

国内半导体封测龙头，半导体涨价潮已扩散到晶圆代工端，公司一季度扣非净利润增速超 90%

摘要：近期融资买入情况活跃。

作者：市值风云 App：天成 henry

公司近期看点：

- 1、一季度是公司盈利低点，全年逐季增长。
- 2、受益存储市场的巨大成长。
- 3、收购一家半导体公司 80%股权，拓宽存储器封测布局。
- 4、新工艺已按计划进入稳定量产阶段。

以下为付费部分（不可见）

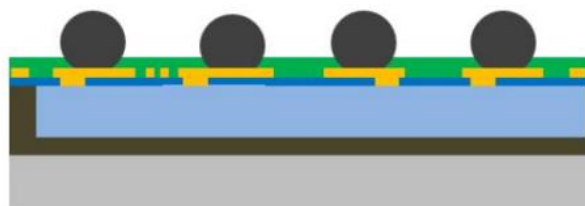
一、公司简介及业绩情况

长电科技提供全方位的芯片成品制造一站式服务，包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。

公司在中国、韩国及新加坡拥有两大研发中心和六大集成电路成品生产基地，业务机构分布于世界各地，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。

通过高集成度的晶圆级 WLP、2.5D/3D、系统级（SiP）封装技术和高性能的 Flip Chip 和引线互联封装技术，长电科技的产品、服务

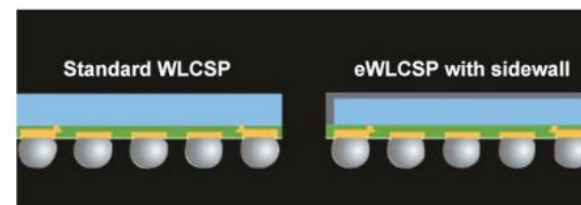
和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、移动终端、高性能计算、汽车电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。



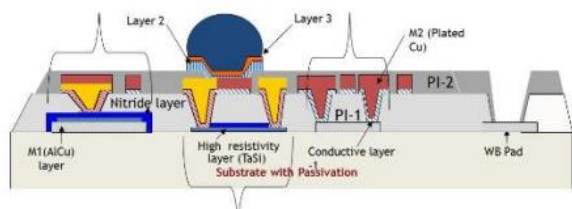
封装芯片封装 (ECP)



嵌入型晶圆级BGA封装 (eWLB)



晶圆级芯片尺寸封装(WLCS)



集成型被动器件 (IPD)

(长电科技晶圆级封装技术解决方案)

2023 年全球终端市场需求疲软，半导体行业处于下行周期，导致客户需求下降，产能利用率降低。同时，受价格承压影响，整体利润下降。公司 2023 年营收 296.6 亿元，同比下降 12.2%；归母净利润 14.7 亿元，同比下降 54.5%，扣非净利润 13.2 亿元，同比下降 53.3%。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 68.4 亿元，较上年同期上升 16.8%；实现归母净利润 1.4 亿元，同比增加 23%；扣非净利润 1.1

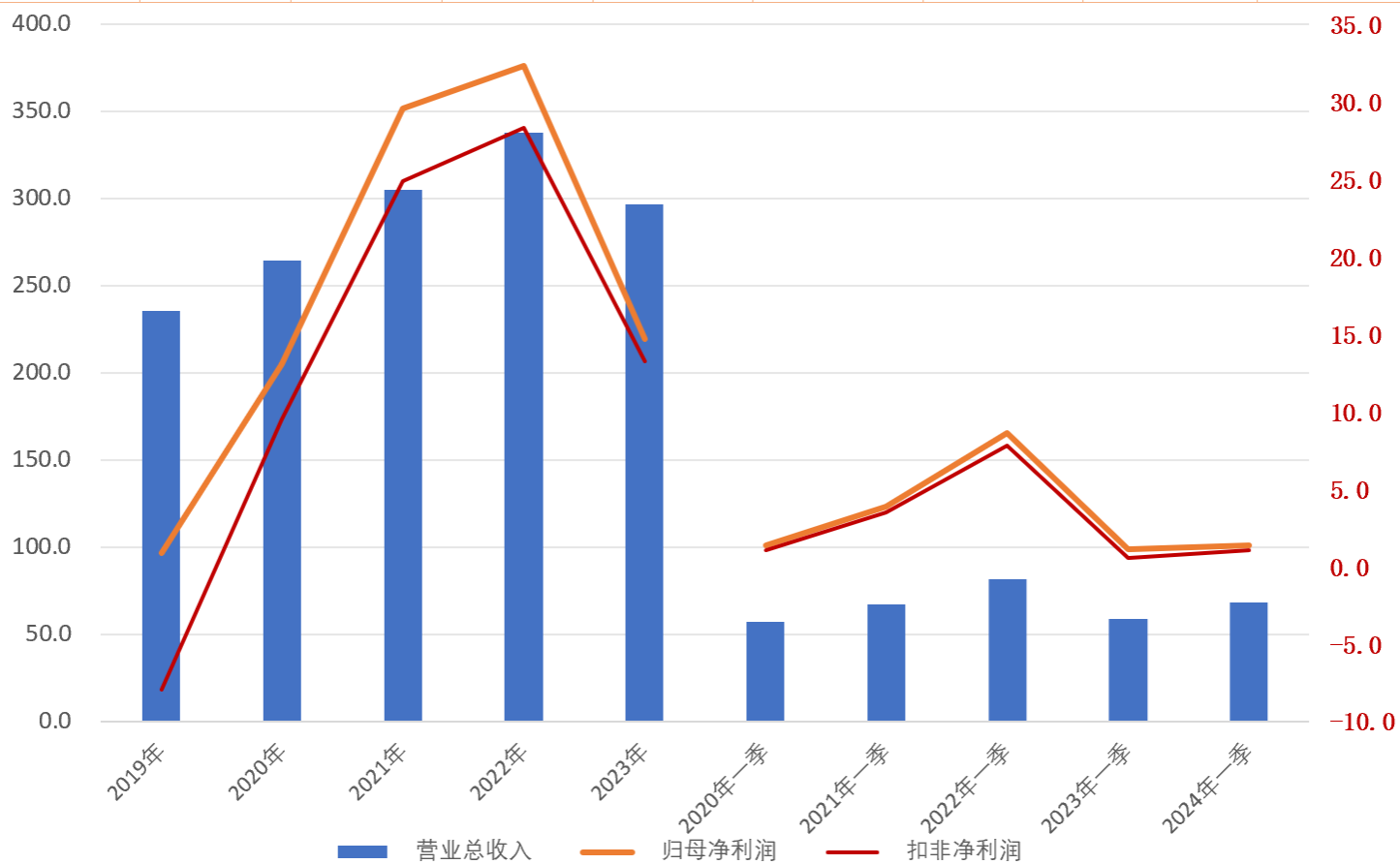
亿元，较上年同期上升 91.3%，扣非净利润大增主要由于部分客户业务量上升，且公司产能利用率提高，增强了盈利能力；同时，公司 2024 年一季度收到计入当期损益的政府补助 1896 万元，按照 2023 年 12 月 22 日中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》所规定，对公司损益产生持续影响的政府补助列为经常性损益，若扣除政府补助项目，则剩余扣非归母净利润部分仍实现 58.2% 同比增长。

展望后市，半导体周期复苏，AI 驱动先进封装需求增长。随着消费市场需求趋于稳定，人工智能与高性能计算等热点应用领域带动，以及市场去库存效果明显和存储器市场的推动等多重因素作用下，2024 年全球半导体市场重回增长轨道。其中，存储有望成为主要增长动力，AI 服务器/PC/手机等应用落地渗透也将成为行业成长新驱动。

根据芯思想研究院发布的 2023 年全球委外封测榜单，长电科技在全球前十大 OSAT 厂商中排名第三，中国大陆第一，市场地位稳固。

长电科技业绩变动情况（亿元）

项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2020年一季	2021年一季	2022年一季	2023年一季	2024年一季
营业总收入	235.3	264.6	305.0	337.6	296.6	57.1	67.1	81.4	58.6	68.4
归母净利润	0.9	13.0	29.6	32.3	14.7	1.3	3.9	8.6	1.1	1.4
扣非净利润	-7.9	9.5	24.9	28.3	13.2	1.1	3.5	7.8	0.6	1.1



（数据来源：Choice 金融终端，制图：市值风云 APP）

二、涉及概念

- 1、先进封装：公司主营业务为半导体封装业务。
- 2、汽车芯片：长电科技 2023 年 10 月 28 日公告控股子公司长电科技汽车电子（上海）有限公司获增资合计 44 亿元，进一步聚焦车载领域业务发展，加快其汽车芯片成品制造封测一期项目的建设。
- 3、存储芯片：在半导体存储市场领域，公司的封测服务覆盖 DRAM、Flash 等各种存储芯片产品，拥有 20 多年 Memory 封装量产经验，16 层 NAND Flash 堆叠，35um 超薄芯片制程能力，Hvbrid 异型堆叠等，都处于国内行业领先的地位。
- 4、汽车电子：在车载电子领域，长电科技成立有专门的汽车电子 BU，进一步布局车载电子领域，产品类型覆盖信息娱乐、ADAS、传感器和电子系统等多个汽车电子产品应用领域。
- 5、中芯国际概念：中芯国际是公司第二大股东芯电半导体（上海）有限公司的实际控制人，同时，中芯国际与公司是芯片制造产业链前后道紧密的合作伙伴。

三、事件催化

- 1、半导体产业链的涨价潮自 5 月开始逐步扩散，周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散。
- 2、半导体封测设备整体国产化率仍偏低，随着先进封装产线扩产推进，对相关设备的需求也将增加，国内封装设备厂在先进封装领域积极布局，有望在国产替代大潮中获取更多市场份额。

四、市场行为

（一）机构调研

4 月份业绩说明会信息显示，长电科技在 1) 汽车电子领域，2023 年汽车电子业务实现营收超 3 亿美金，同比增长 68%。2) 算力领域，公司推出的 XDF0I@Chiplet 高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，涵盖 2D、2.5D、3D 集成技术，经过持续研发与客户产品验证，已在高性能计算、人工智能、5G、汽车电子等领域应用。3) 存力领域，2024 年 3 月 4 日，长电科技管理有限公司与西部数据签署股权收购协议，拟收购晟碟半导体 80% 股权，既拓宽了存储器封测布局，也加深了与西部数据等存储芯片巨头的合作。

今年在市场方面可以看到，所有的算力中心用在 AI 主板上，集成供电管理芯片上的密度和用电的密度越来越高，GPU 的耗电水平呈现指数级增长。今年以先进封装的形式做高密度供电的业务量跟去年相比将增长数倍，而且这一趋势才刚刚开始并持续扩大。

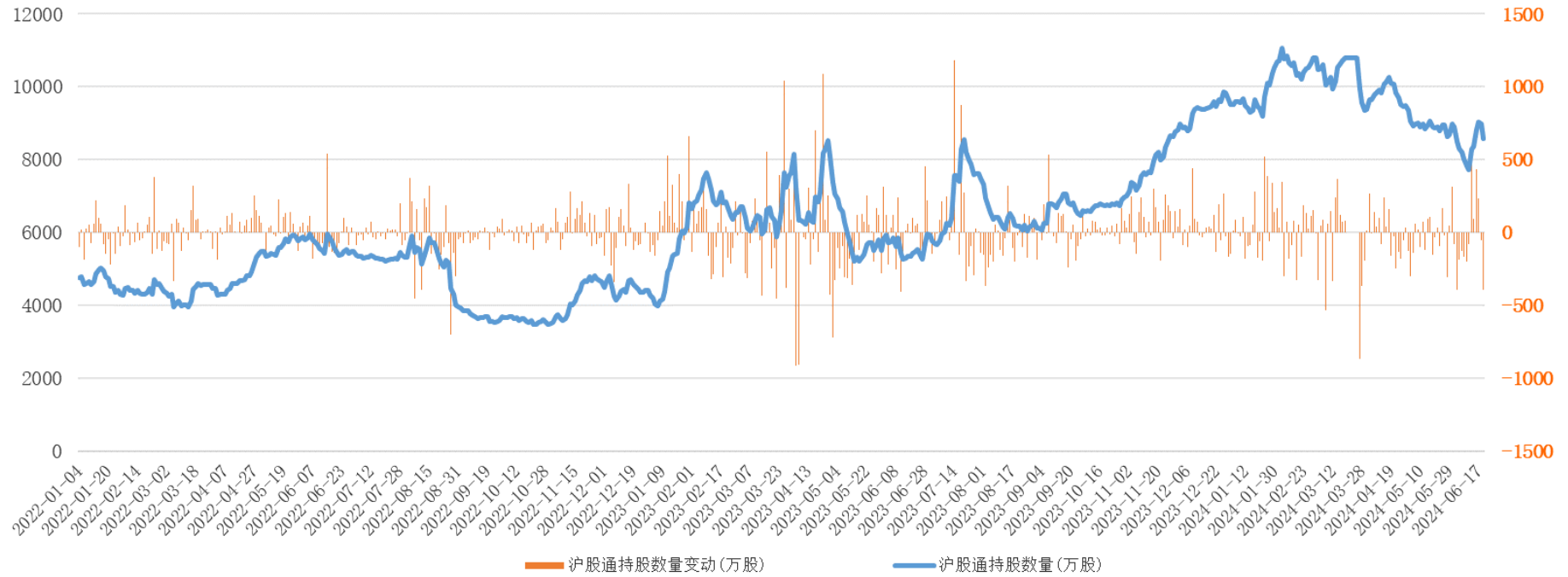
我们非常看好存储市场的增长，已经超出了正常半导体的一般性的周期的回暖，受到 AI 驱动未来会有巨大的成长。所以我们和西部数据这样全球顶尖的存储厂家的合作，并通过并购的业务，实现了走向全球的战略及对国内的高密度闪存的需求非常好的推动。闪存走向高密度的时候也要采取先进的封装形式，以实现更高的带宽和速度的提升。

第二季度我们将力争实现收入及利润的环比正向增长。预计第一季度是公司盈利的低点。全年公司将力争实现逐季度的业绩成长，紧抓行业的成长机遇。

（二）投资者持仓

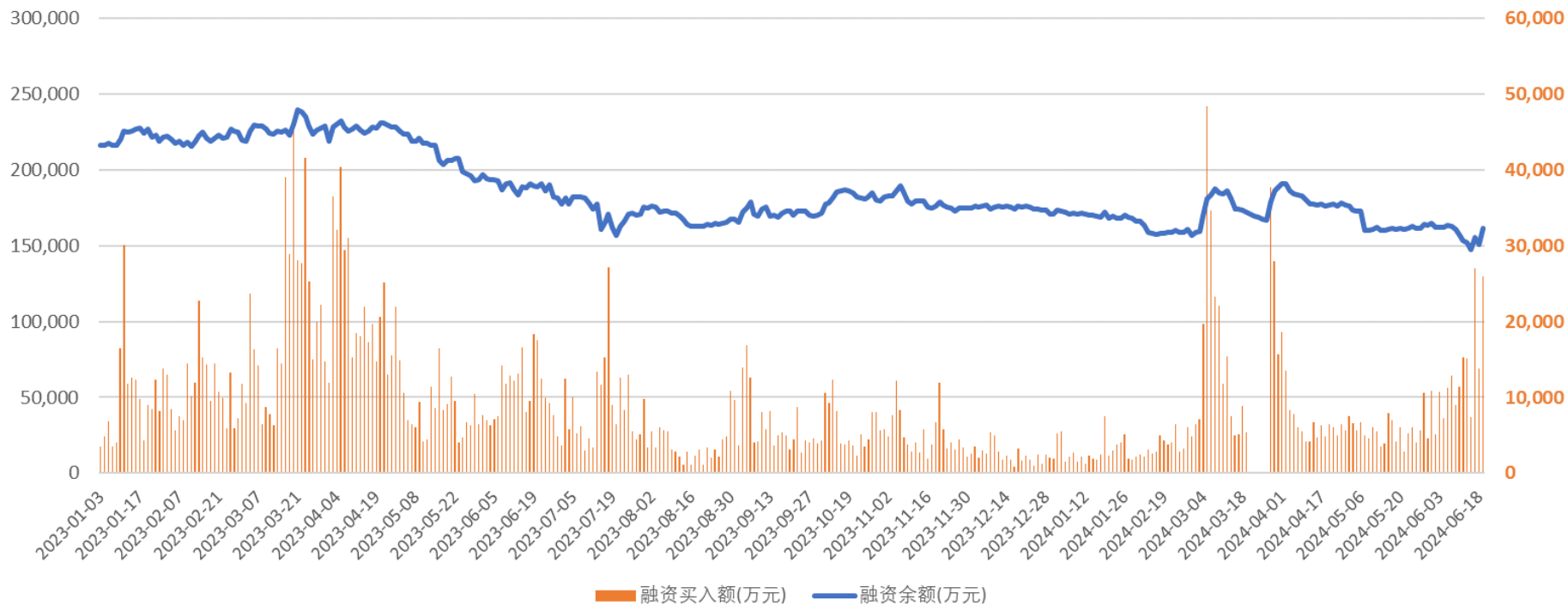
近期“北向资金”有所流入，沪股通持股数量有所增加。

“北向资金”持仓长电科技变动情况



(数据来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

近期融资买入情况活跃, 融资余额上升。



(数据来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

2024 年一季度公司前十大流通股股东中持股比例最高为国家大基金, 第二大股东实际控制人为中芯国际。

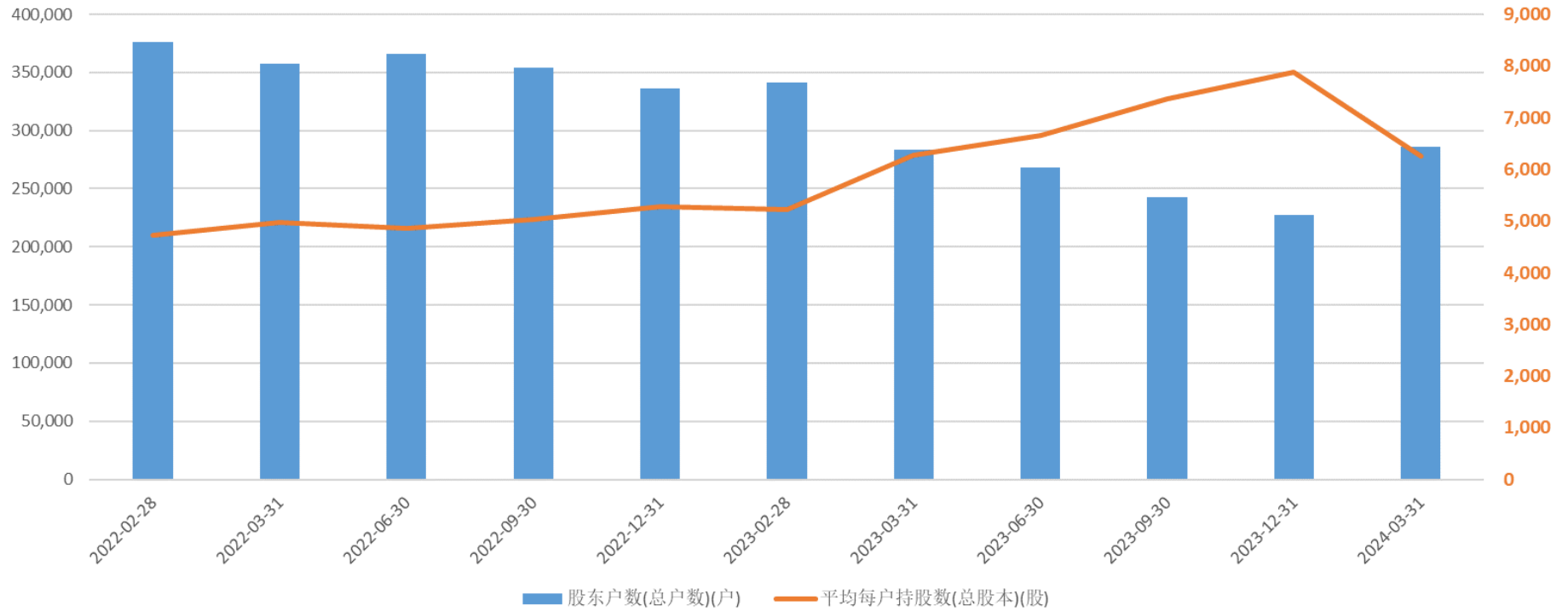
2024一季度长电科技前十大流通股股东持仓情况

股东名称	股东性质	持股数量 (万股)	占总股本比例 (%)	占无限售流通股 比例 (%)	较上期持股变动数 (万股)
国家集成电路产业基金	投资公司	23,689.8	13.2	13.2	不变
芯电半导体(上海)公司	其它	22,883.4	12.8	12.8	不变
香港中央结算有限公司	其它	9,550.5	5.3	5.3	-291.7
银河创新成长混合基金	基金	3,750.0	2.1	2.1	-150.0
华夏国证半导体芯片ETF	基金	3,171.3	1.8	1.8	-167.8
无锡金投领航产业升级并购投资	投资公司	2,316.4	1.3	1.3	不变
天水华天科技公司	其它	2,230.8	1.2	1.2	新进
国联安中证全指半导体产品与设备ETF	基金	2,042.9	1.1	1.1	-381.3
兴全趋势投资混合基金	基金	1,719.4	1.0	1.0	219.4
华泰柏瑞沪深300ETF	基金	1,540.8	0.9	0.9	新进
合计		72,895.3	40.7	40.7	

(数据来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)

一季度公司股东数有所上升, 平均每户持股数有所下降。

长电科技股东户数变动情况



(数据来源: Choice 金融终端, 制图: 市值风云 APP)